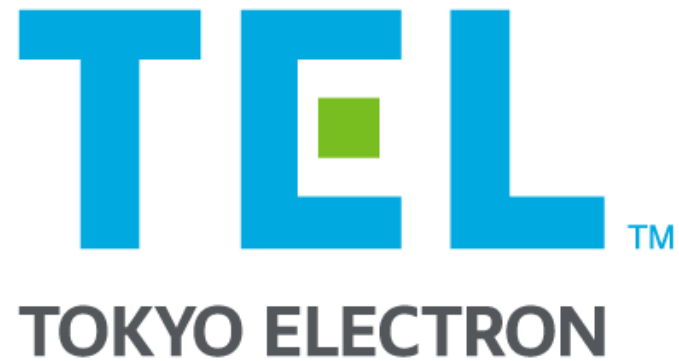


# 第54期 定時株主総会



平成29年6月20日

# 第54期 業績報告

# 連結損益計算書

	第53期		第54期		増減
		(%)		(%)	
売上高	6,639	100.0	7,997	100.0	+1,357
SPE	6,130	92.3	7,498	93.8	+1,368
FPD	446	6.7	493	6.2	+46
その他	62	1.0	4	0.0	△57

(億円)

SPE: 半導体製造装置

FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

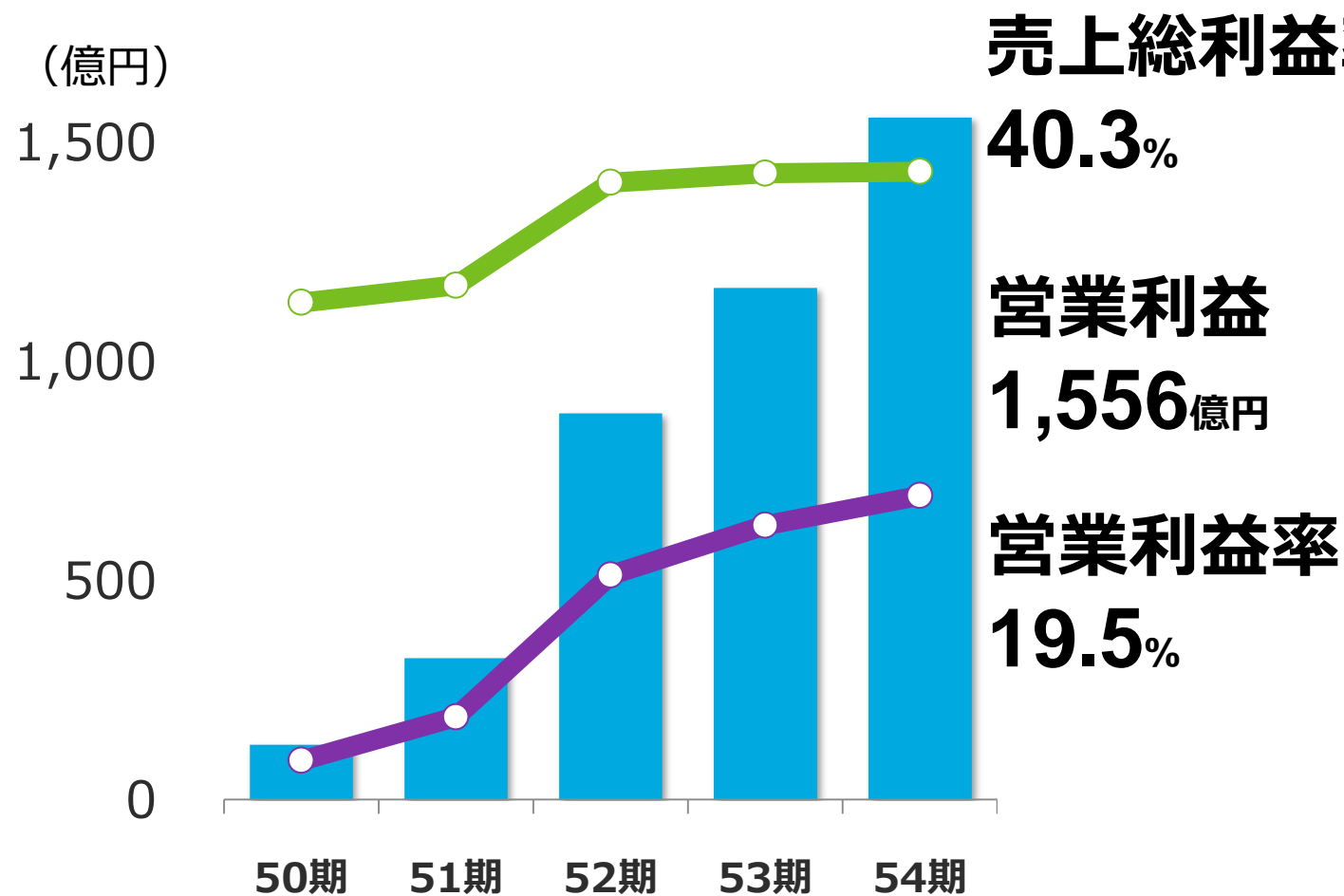
**連結売上は市場成長率を超えた前期比+20%の増収、  
半導体製造装置の売上高は過去最高を記録**

# 連結損益計算書

	第53期		第54期		増減	(億円)
		(%)		(%)		
売上高	6,639	100.0	7,997	100.0	+1,357	
売上総利益	2,672	40.2	3,222	40.3	+550	
営業利益	1,167	17.6	1,556	19.5	+389	
経常利益	1,193	18.0	1,575	19.7	+381	
特別利益	14		0		△14	
特別損失	144		84		△59	
税引前利益	1,064	16.0	1,491	18.6	+426	
親会社株主に帰属する当期純利益	778	11.7	1,152	14.4	+373	

当期純利益は過去最高を記録

# 連結損益ハイライト



売上総利益率

40.3%

営業利益

1,556億円

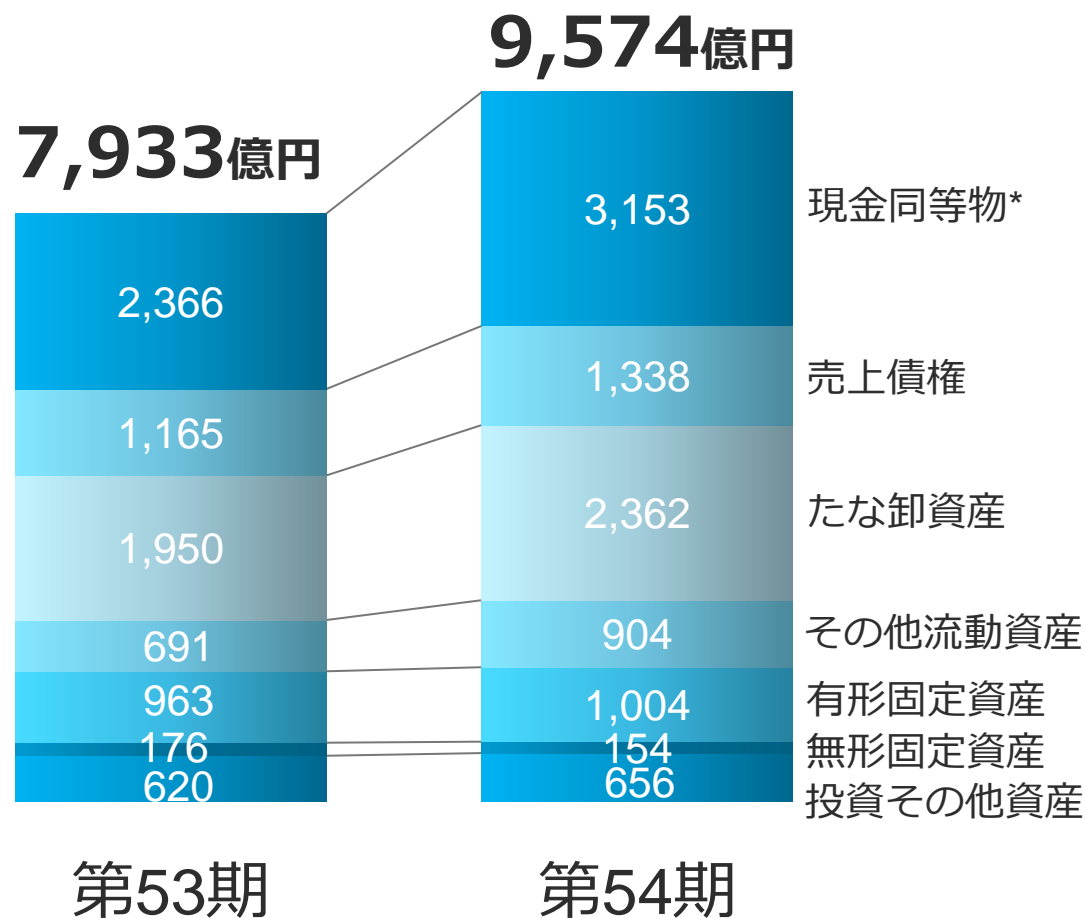
営業利益率

19.5%

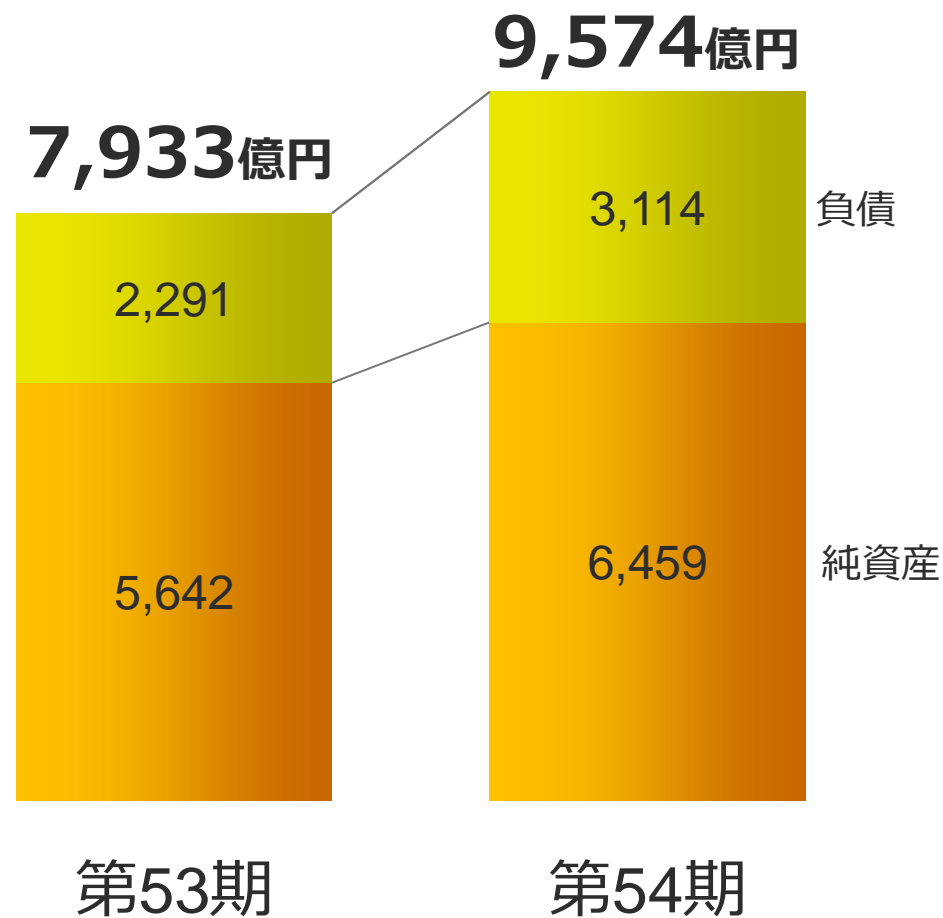
売上総利益率・  
営業利益率ともに  
過去最高を記録

# 連結貸借対照表

## 資産

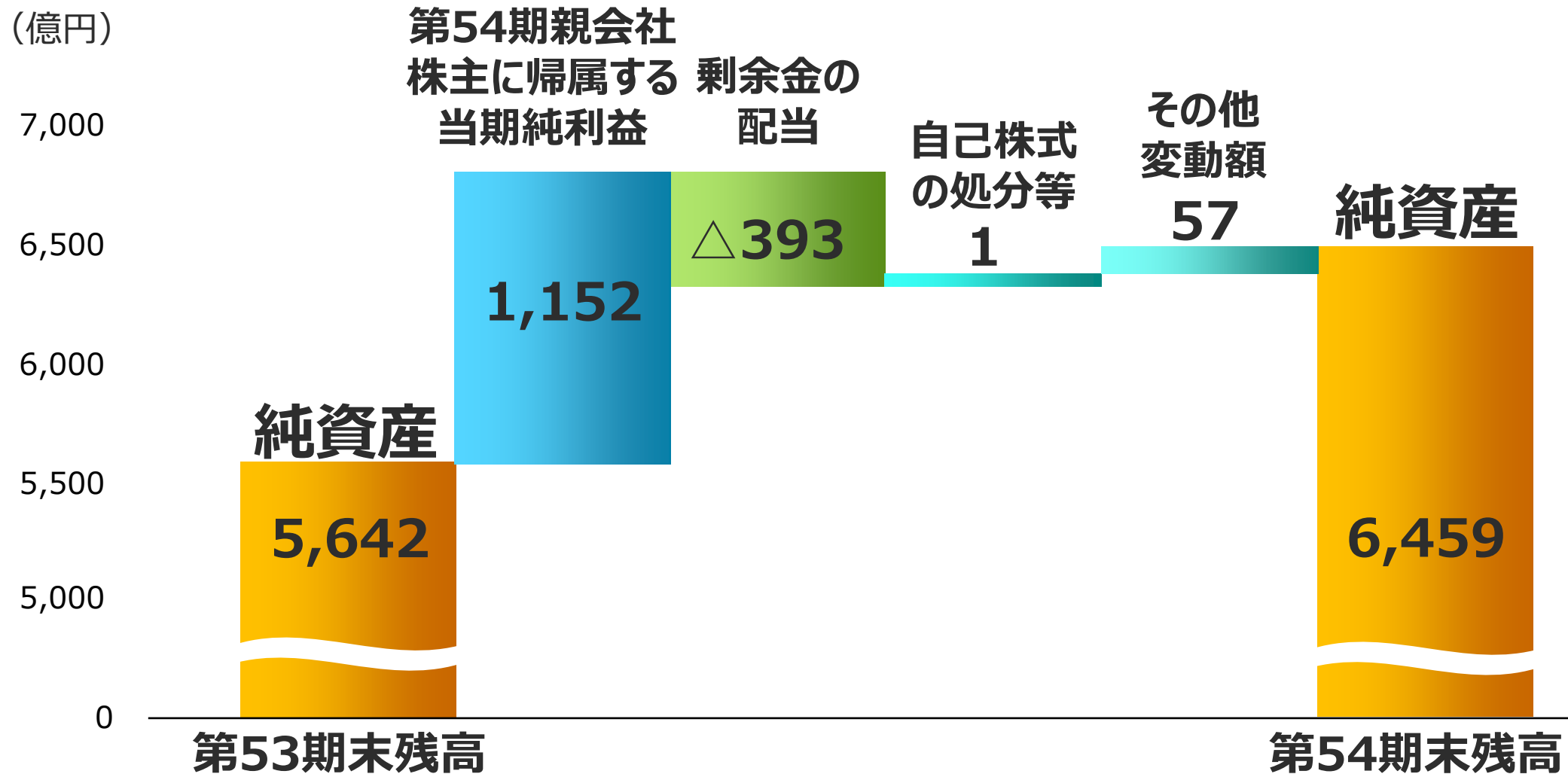


## 負債・純資産



\*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

# 連結株主資本等変動計算書



# 単独財務諸表の概要

損益計算書	第53期 (%)		第54期 (%)		増減
売上高	5,826	100.0	7,510	100.0	+1,684
営業利益	420	7.2	605	8.1	+184
経常利益	748	12.8	618	8.2	△129
税引前利益	785	13.5	638	8.5	△147
当期純利益	635	10.9	466	6.2	△168

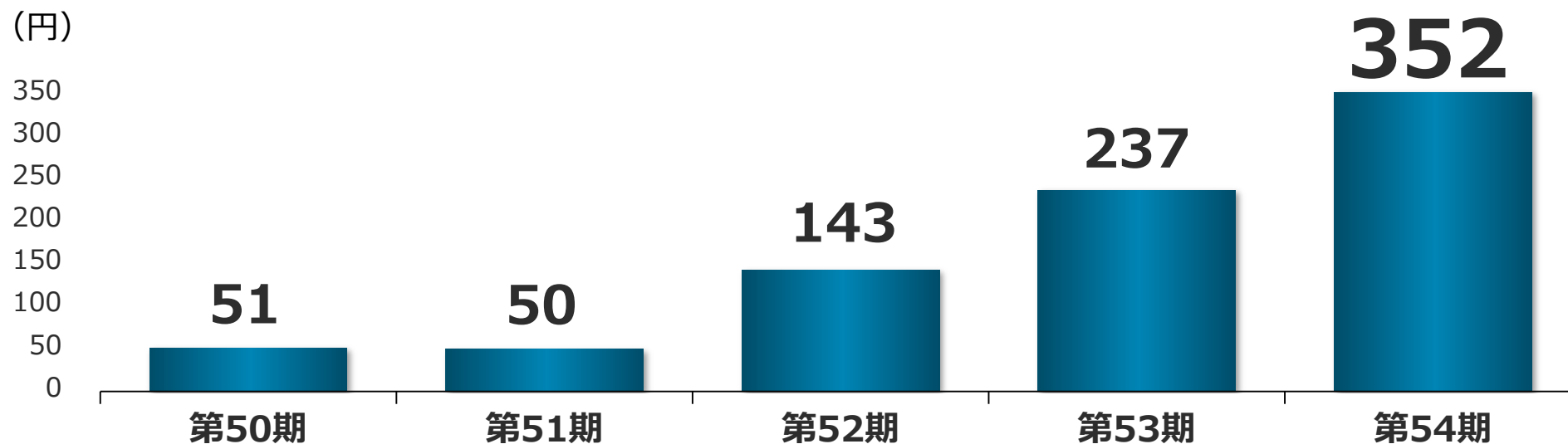
(億円)

貸借対照表	第53期 (%)		第54期 (%)		増減
資産合計	6,259	100.0	7,686	100.0	+1,426
負債合計	2,966	47.4	4,281	55.7	+1,315
純資産合計	3,293	52.6	3,405	44.3	+111
負債・純資産合計	6,259	100.0	7,686	100.0	+1,426



# 第54期配当

## ▶ 1株当たり配当金



	中間	期末	年間
第54期	128	224	352

配当総額	連結配当性向
577億円	50.1%

# 第55期 業績見通し

# 事業環境

## ■ 半導体設備(SPE)投資

半導体前工程の設備投資額は、次世代3次元構造 NAND フラッシュメモリおよび先端デバイス向けロジック投資の立ち上がりにより、前年比10%程度の成長を予想

## ■ フラットパネルディスプレイ(FPD)設備投資

FPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と大型パネル向け投資の立ち上がりにより、前年比30%程度の増加を見込む

# 第55期 連結業績見通し

	上期	下期	通期	前期比
売上高	4,800	5,000	9,800	+22.5%
SPE	4,510	4,590	9,100	+21.4%
FPD	290	410	700	+41.7%
営業利益	1,040 21.7%	1,120 22.4%	2,160 22.0%	+38.7% +2.5pts
経常利益	1,040	1,120	2,160	+37.1%
税引前利益	1,040	1,120	2,160	+44.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	790	840	1,630	+41.5%

(億円)

SPE: 半導体製造装置      FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

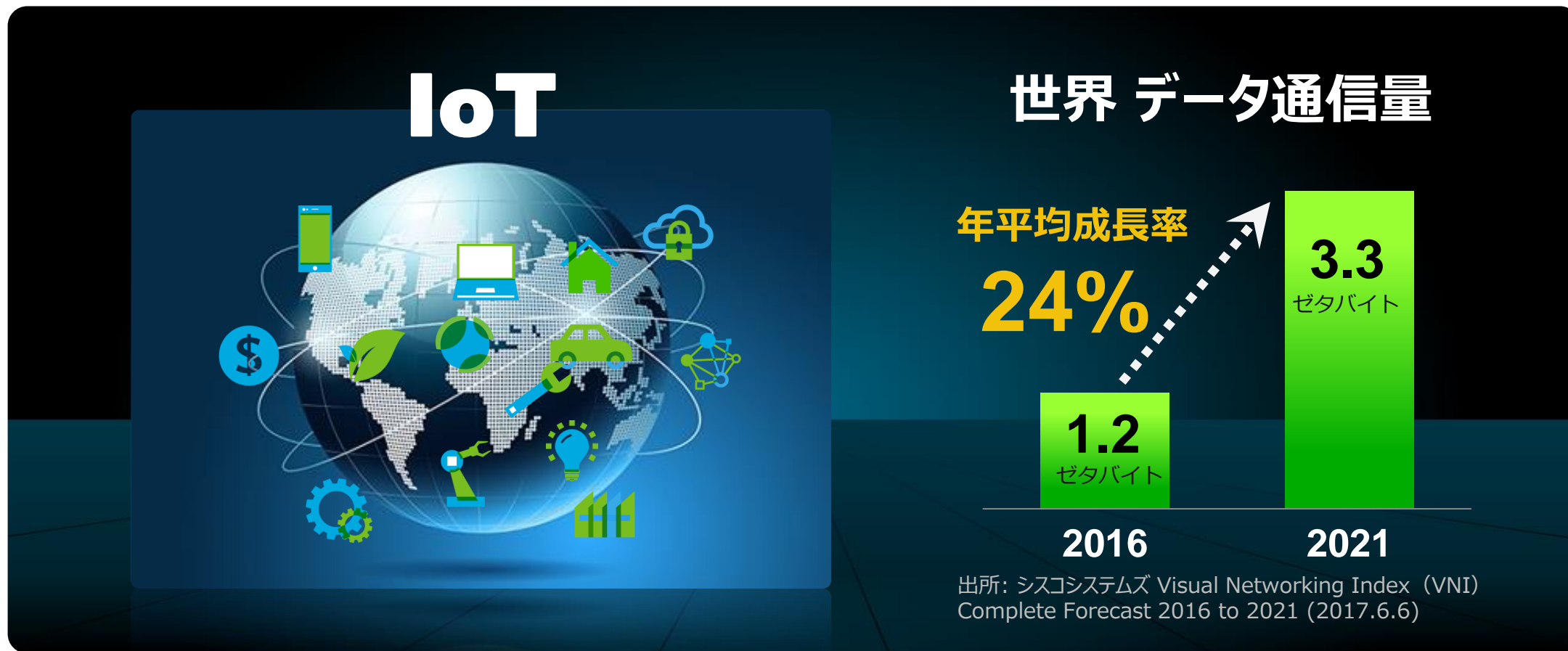
**市場成長率の倍以上の売上拡大、  
2期連続の過去最高益を見込む**

# 更なる成長を目指して

1. 事業環境と当社のビジネス
2. 中期経営計画
3. 株主還元

# 1. 事業環境と当社のビジネス

# IoT時代の到来



## ネットに繋がるモノが増え、データ通信量が劇的に増加

# IoT時代を支えるインフラの進化



クラウド、データセンター

ビッグデータ処理でデータセンターのサーバーが高性能に



# IoT時代を支えるインフラの進化



## 次世代通信規格5G導入で、IoT社会のインフラが整う

# 5Gが実現するサービス

## 快適な動画配信



## 自動運転



5G

4Gをはるかに超える通信容量やスピードが、新サービスを生む

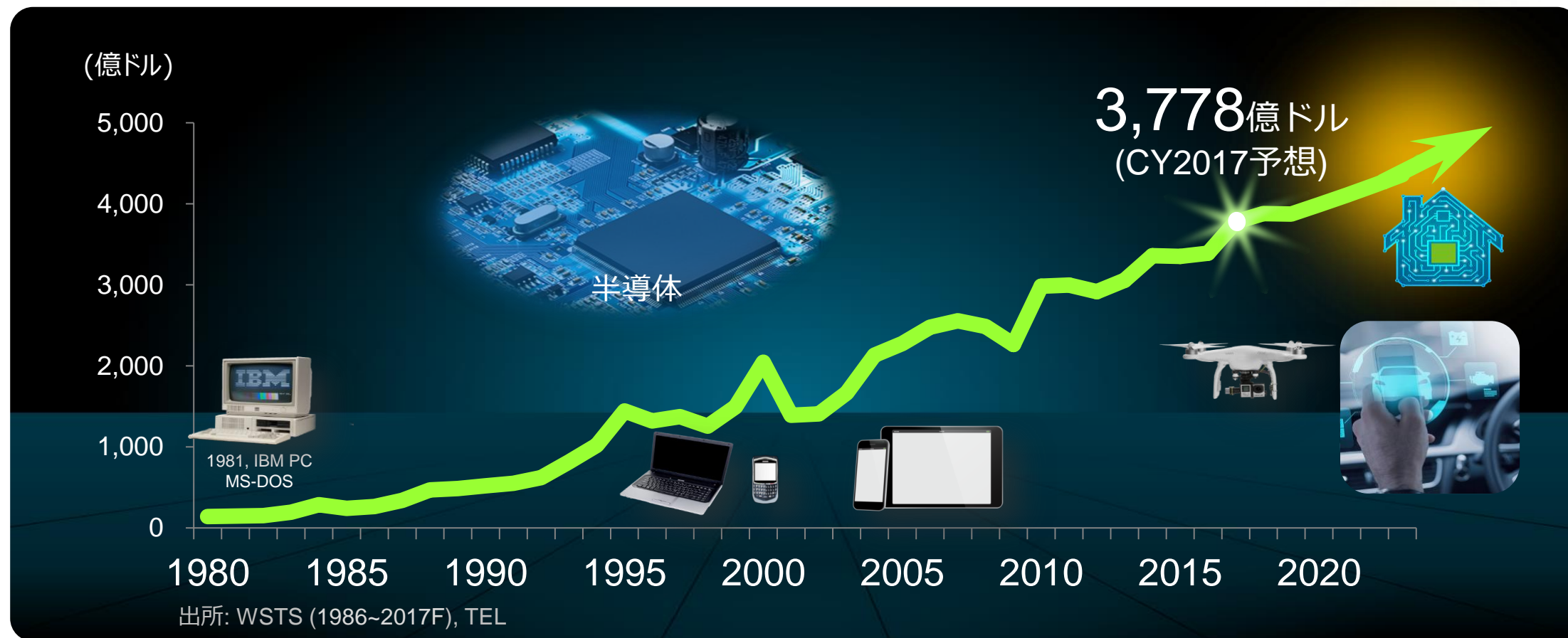
# 社会の進化



社会全体における半導体の集積度が上がる

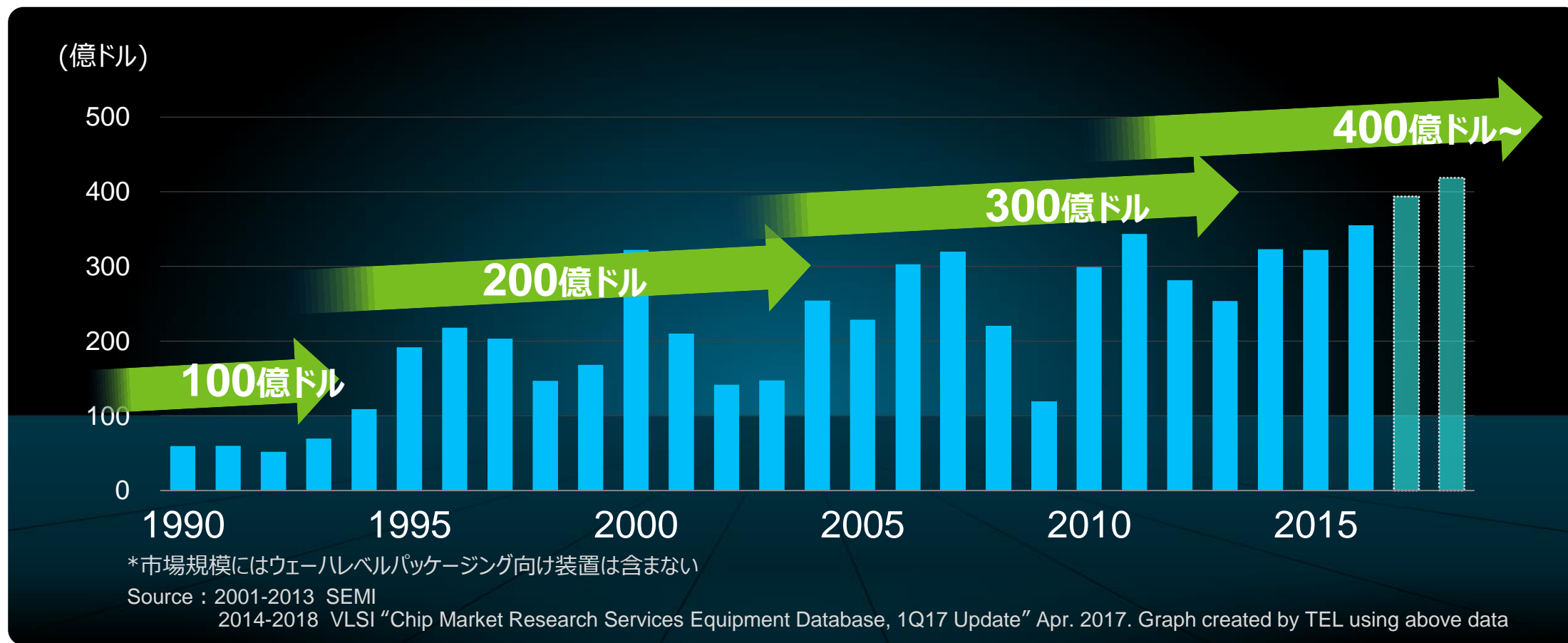
# 半導体産業は 一段上の成長フェーズへ

# 世界半導体市場



## IoTを迎え、半導体市場は大きく拡大

# WFE\* (半導体前工程製造装置) 市場の拡大



## 半導体製造装置市場は次なる成長フェーズへ

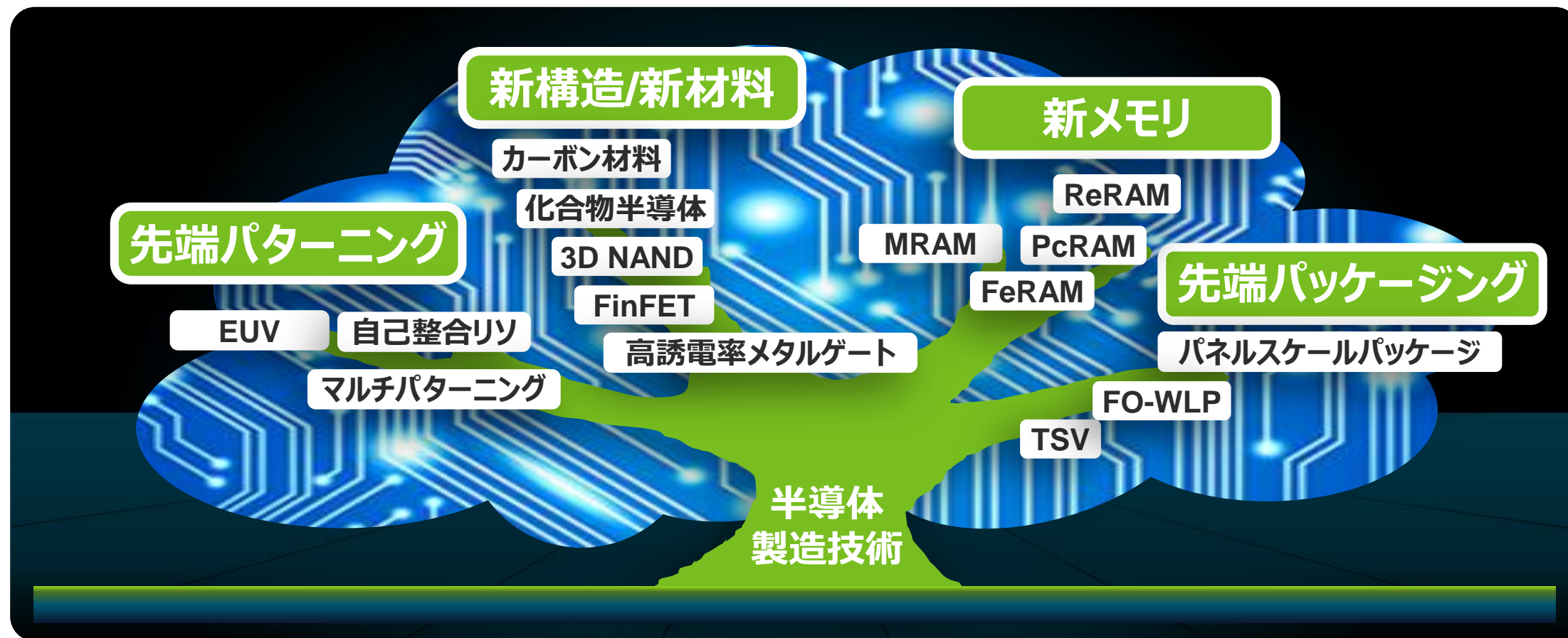
\* WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。  
 半導体前工程装置 (WFE) は、この前工程で使用される製造装置です。

# 驚くべき半導体の微細化レベル



## 半導体技術は究極のナノエレクトロニクスへ

# 半導体の進化



多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える



# 当社の半導体製造装置

## 半導体製造装置



コータデベロッパ  
CLEAN TRACK™  
LITHIUS Pro™ Z



枚葉洗浄装置  
CELLESTA™-j



プラズマエッチング装置  
Tactras™ Vigus™



熱処理成膜装置  
TELINDY PLUS™



ALD装置  
NT333™



枚葉成膜装置  
Triase+™ EX-II™ TiN



マルチセルテストシステム  
Cellcia™

卓越した装置性能と豊富な製品群で技術革新を推進

# IoTでディスプレイ産業も成長

# インターフェイスデバイスとしてのディスプレイ用途の拡大

ディスプレイに求められる性能

**超高精細化・低消費電力化・フレキシブル（加工性）**



スマートフォン



ヘッドマウント・ディスプレイ



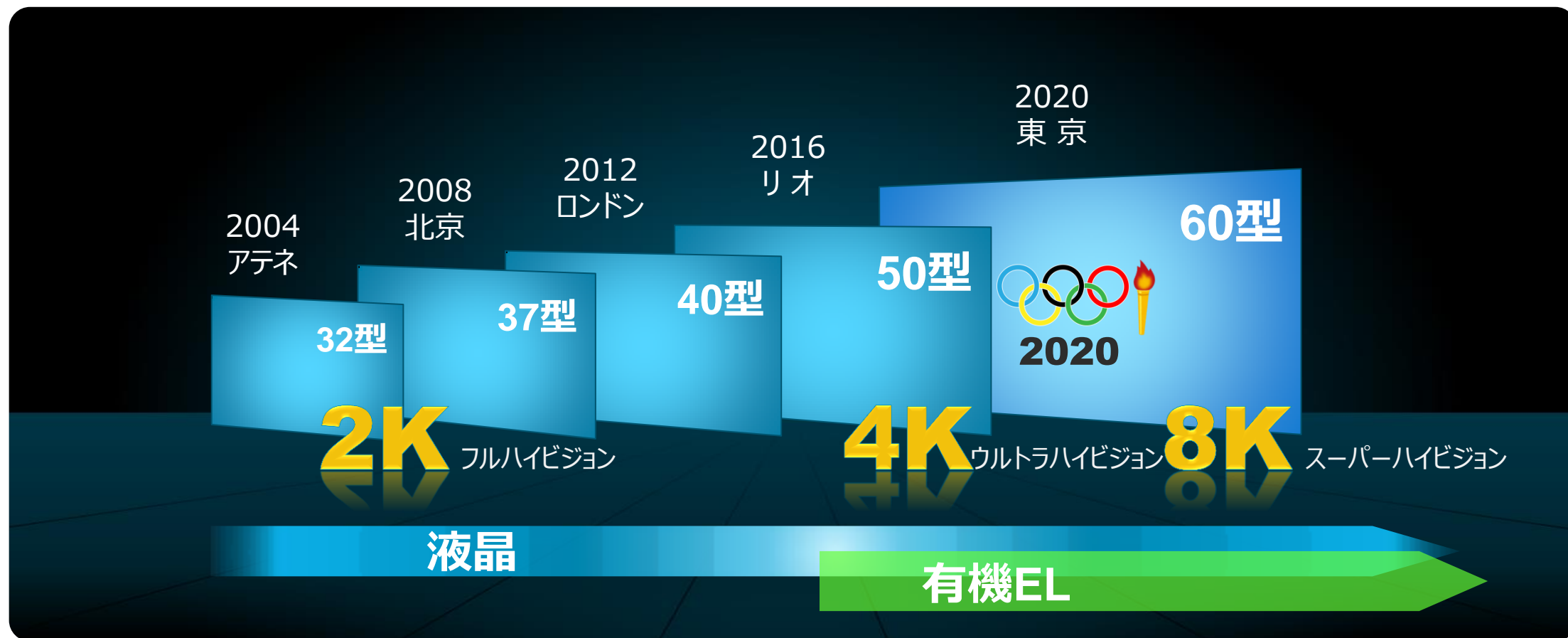
車載ディスプレイ



フレキシブルディスプレイ

## ディスプレイ市場も更なる拡大と技術進化を継続する

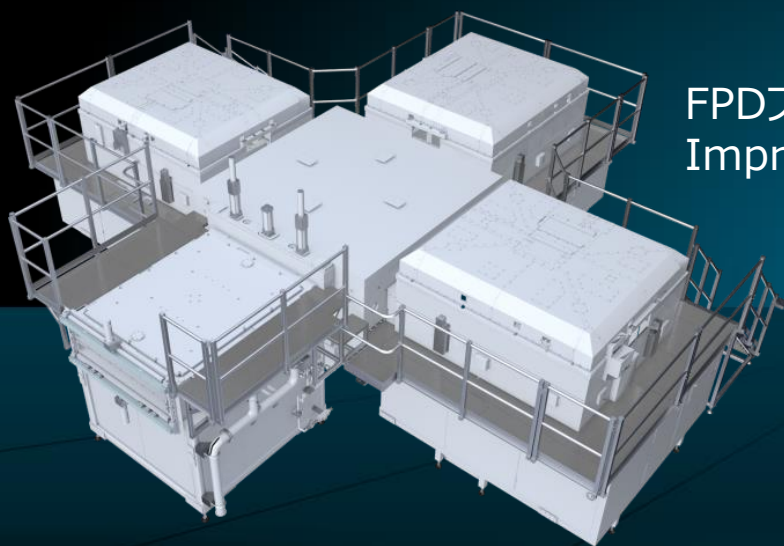
# テレビ画面に起こる進化



さらなる大画面、高画質へ  
有機ELテレビも参入メーカーが増加

# 当社のFPD製造装置

## FPD製造装置



FPDプラズマエッチング/アッシング装置  
Impressio™



有機ELパネル製造用インクジェット描画装置  
Elius™

# 急成長する有機ELディスプレイ装置市場に新製品投入

**付加価値の高い、  
我々だからできる、  
世の中にない技術を創造し  
提供していく**

**TELの強みは  
最先端装置の  
開発と販売だけではない**

# サービス事業への注力

世界装置出荷台数  
業界最大の **62,000台**

**最先端製造装置**  
開発・製造・販売

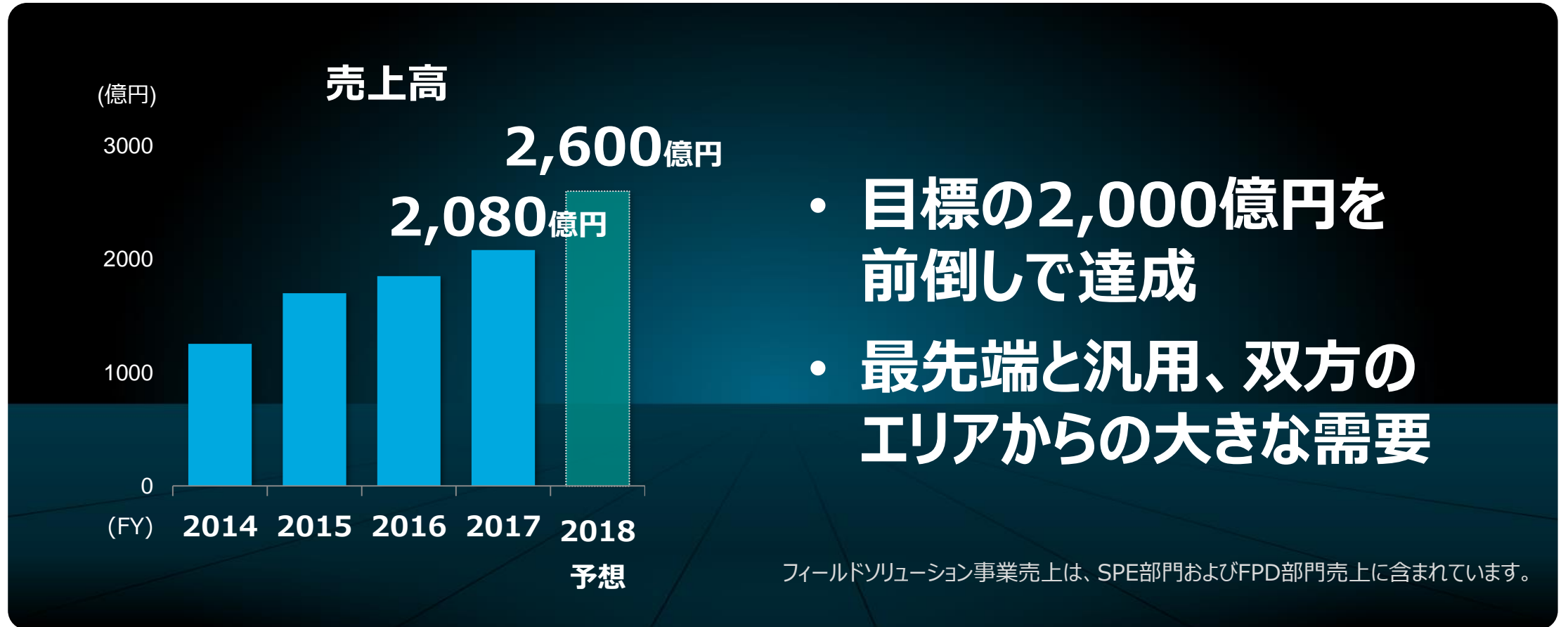
**フィールドソリューション**  
サービス契約・アップグレード  
リペア・パーツ・中古

遠隔診断技術  
TELeMetrics™

販売した装置が新たな事業機会になり価値を生む



# 伸びるフィールドソリューション事業



## IoTのもたらす幅広い需要で収益拡大

**装置を起点とし、  
顧客の半導体・ディスプレイの製造を  
総合的にサポート**

## 2. 中期経営計画

# 中期事業目標 進捗

	2015/3 実績	2017/3 実績	2018/3 予想	中期事業目標 (2015年7月発表)	
WFE* 市場規模	319億ドル	350億ドル	380億ドル	300億ドル	370億ドル
売上高	6,131億円	7,997億円	9,800億円	7,200億円	9,000億円
営業利益率	14.4%	19.5%	22.0%	20%	25%
ROE	11.8%	19.1%	-	15%	20%

## 順調に業績向上。引き続き利益率向上に注力

\* WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。  
半導体前工程装置 (WFE) は、この前工程で使用される製造装置です。ここでの市場規模にはウェーハレベルパッケージング向け装置は含みません。

# 市場環境の変化を踏まえて 新目標を設定

# 新中期事業目標

\*市場規模にウェーハレベルパッケージング向け装置を含む

**WFE\***  
**市場規模**

**420億ドル**  
(4兆6千億円)

**450億ドル**  
(5兆円)

**売上高**

**1兆500億円**

**1兆2000億円**

**営業利益率**

**24%**

**26%**

**ROE (自己資本利益率)**

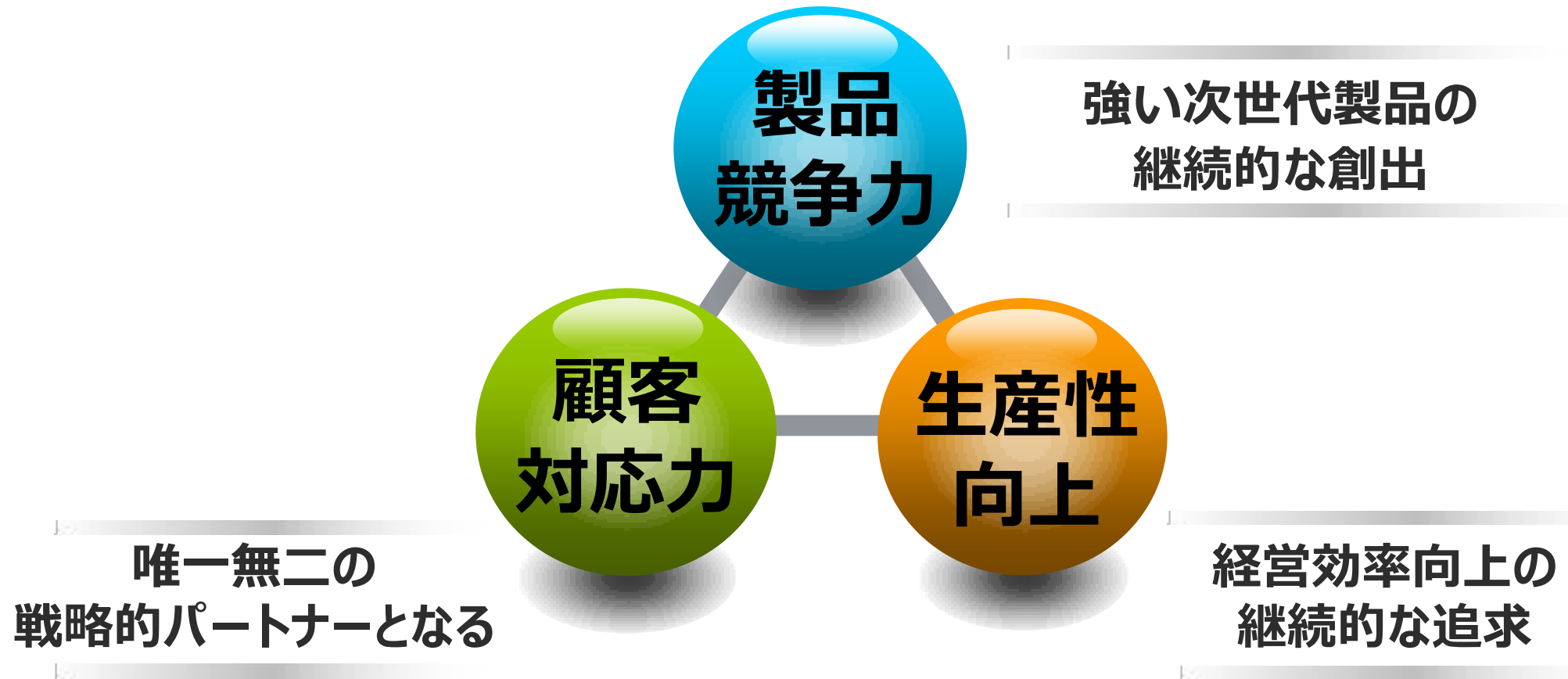
**20%~25%**

\*換算レート110円/ドル

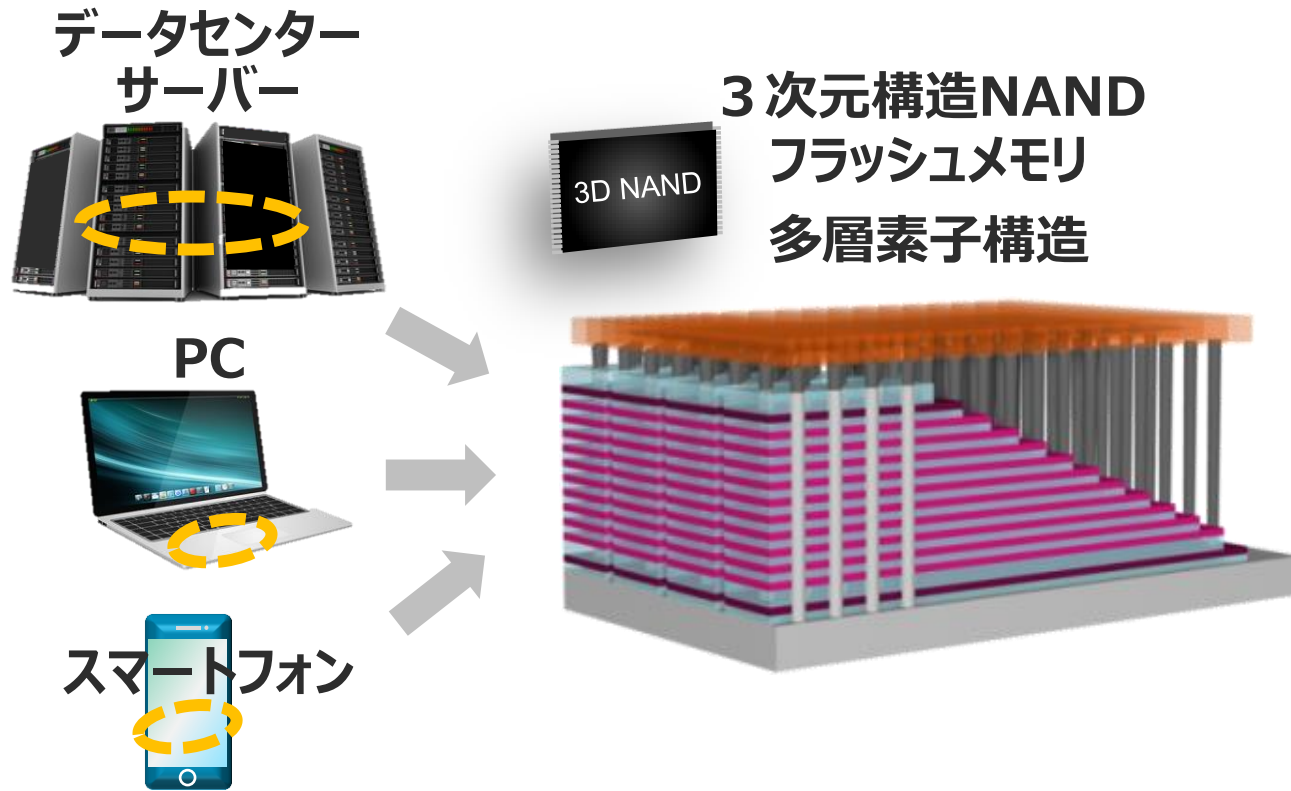
## グローバル水準の利益率の達成を目指す

# 3つの強化項目

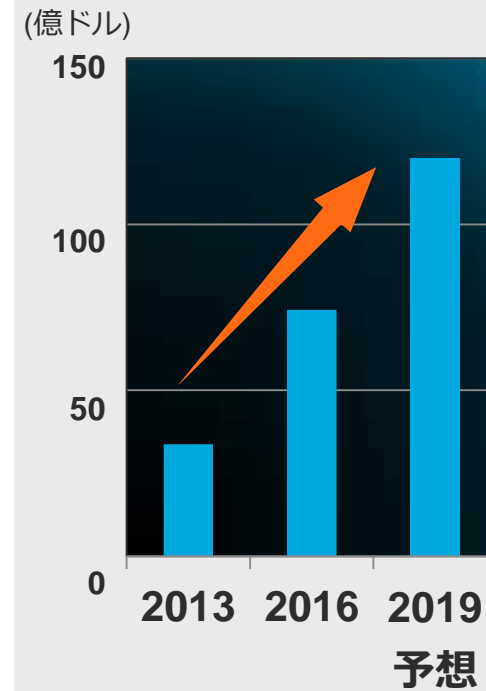
利益の追求、企業価値の向上



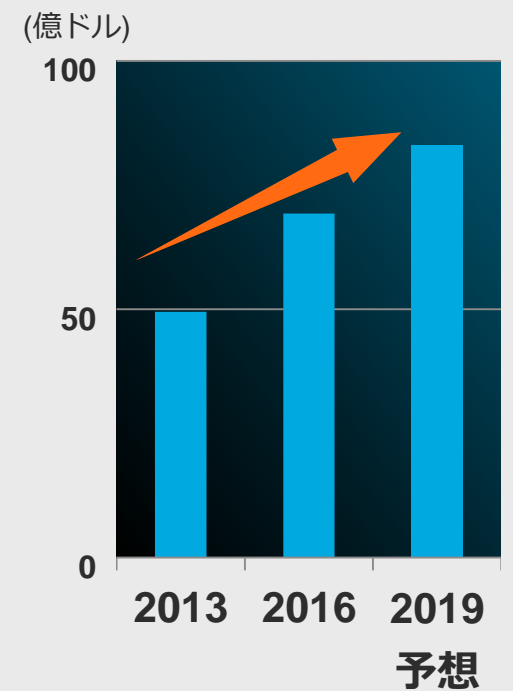
# 3次元構造NANDフラッシュメモリが装置需要を牽引



### エッチング装置市場



### 成膜装置市場



## 積層数の増加で、エッチング、成膜装置に大きな事業機会



# エッチング装置事業の強化 (東京エレクトロン宮城)

新開発棟

2018年8月竣工予定

物流棟

2017年12月竣工予定



今後需要拡大が見込まれる  
エッチング装置



Tactras™ Vigus™

## 製品競争力の強化、生産性向上

# 成長フェーズだからこそ 体質を強化

# 3. 株主還元

# 株主還元に関する基本的考え方

**革新的技術力・独創的提案力で付加価値創出**



**利益の追求・企業価値の向上**



**ステークホルダーへの適切な還元**

# 株主還元: 配当政策

**連結配当性向： 50%**

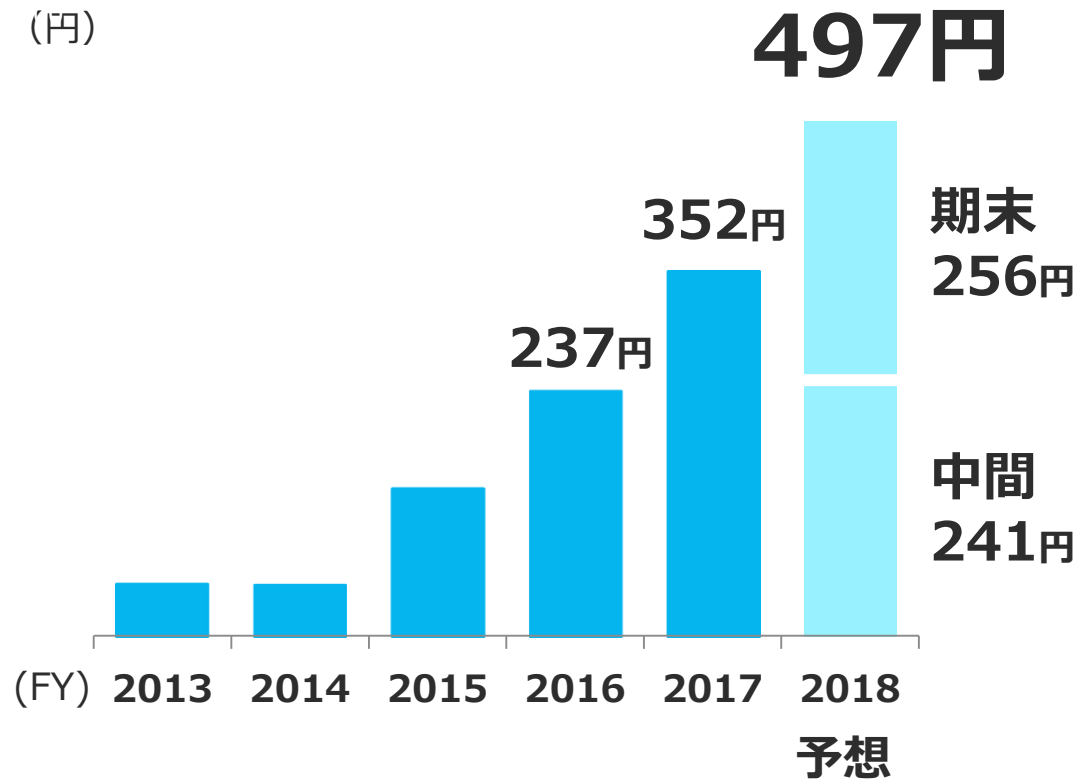
但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

---


2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

# 株主還元: 配当金

## 1 株当たり配当金



**2018年3月期配当、  
前期比40%以上の  
増配を予定**



# 半導体・ディスプレイは 新たな成長フェーズへ



# すべての産業で重要性が高まる 半導体・ディスプレイの進化に 当社の技術で貢献





# グローバル水準の収益性を追求し 持続的な企業価値の向上を目指す

# 決議事項

1. 取締役 12名選任の件
2. 監査役 3名選任の件
3. 第54期取締役賞与金支給の件
4. 当社取締役に対し株式報酬として  
新株予約権を発行する件
5. 当社及び当社子会社の役員等に対し  
株式報酬として新株予約権を発行する件

# 第1号議案

## 取締役 12名選任の件

# 第1号議案 取締役12名選任の件

## <取締役候補者氏名>

- |    |                           |                           |     |                            |                           |
|----|---------------------------|---------------------------|-----|----------------------------|---------------------------|
| 1. | <small>つねいし</small><br>常石 | <small>てつお</small><br>哲男  | 8.  | <small>ながくぼ</small><br>長久保 | <small>たつや</small><br>達也  |
| 2. | <small>かわい</small><br>河合  | <small>としき</small><br>利樹  | 9.  | <small>すのはら</small><br>春原  | <small>きよし</small><br>清   |
| 3. | <small>ほり</small><br>堀    | <small>てつろう</small><br>哲朗 | 10. | <small>ひがし</small><br>東    | <small>てつろう</small><br>哲郎 |
| 4. | <small>ささき</small><br>佐々木 | <small>さだお</small><br>貞夫  | 11. | <small>いのうえ</small><br>井上  | <small>ひろし</small><br>弘   |
| 5. | <small>きたやま</small><br>北山 | <small>ひろふみ</small><br>博文 | 12. | チャールズ・デイトマース・<br>レイク二世     |                           |
| 6. | <small>あきもと</small><br>飽本 | <small>まさみ</small><br>正巳  |     |                            |                           |
| 7. | <small>ちよん</small><br>鄭   | <small>ぎし</small><br>基市   |     |                            |                           |

注) 井上弘氏及びチャールズ・デイトマース・レイク二世氏は、  
会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

# 第2号議案

## 監査役3名選任の件

## 第2号議案 監査役3名選任の件

### <監査役候補者氏名>

- |    |                                  |                                   |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | <small>ぬのかわ</small><br><b>布川</b> | <small>よしかず</small><br><b>好一</b>  |
| 2. | <small>やまもと</small><br><b>山本</b> | <small>たかとし</small><br><b>高稔</b>  |
| 3. | <small>わがい</small><br><b>和貝</b>  | <small>きょうすけ</small><br><b>享介</b> |

注) 山本高稔氏及び和貝享介氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

# 第3号議案

## 第54期取締役賞与金 支給の件

# 第3号議案 第54期取締役賞与金支給の件

第54期取締役賞与金	
対象者	第54期末日における取締役11名 (うち社外取締役2名)
報酬額	総額 10億2,900万円 (うち社外取締役分、2,600万円)



# 第4号議案

当社取締役に対し株式報酬として  
新株予約権を発行する件

# 第4号議案 当社取締役に対し株式報酬として 新株予約権を発行する件

取締役に対する株式報酬（新株予約権）	
対象者	本総会で選任される当社取締役 （社外取締役を除く） ※対象者は10名
報酬総額	総額 10億3,400万円の範囲内

# 第4号議案 当社取締役に対し株式報酬として 新株予約権を発行する件

新株予約権の内容	
新株予約権の総数	新株予約権数 1,034個（上限） 当社普通株式 103,400株（上限）
新株予約権の発行価額	無償
1株当たりの払込金額	1円
権利行使期間	総会後開催の取締役会にて決定 （3年間の権利行使制限期間を設定、 行使期間は新株予約権発行日から最長20年間の範囲内）
行使条件	① 新株予約権1個を最低行使単位とする ② その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる

# 第5号議案

当社及び当社子会社の  
役員等に対し株式報酬として  
新株予約権を発行する件

# 第5号議案 当社及び当社子会社の役員等に対し 株式報酬として新株予約権を発行する件

株式報酬（新株予約権）の内容	
対象者	当社執行役員等、子会社取締役、子会社執行役員等
新株予約権の総数	新株予約権数 872個（上限） 当社普通株式 87,200株（上限）
新株予約権の発行価額	無償
1株当たりの払込金額	1円
権利行使期間	総会后開催の取締役会にて決定 （3年間の権利行使制限期間を設定、 行使期間は新株予約権発行日から最長20年間の範囲内）
行使条件	① 新株予約権1個を最低行使単位とする ② その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議及び同決議に基づき締結される新株予約権割当契約に定めるところによる